



新股瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司 IPO 報告分析

一、公司概況

1.1 新股基本資訊

- 股份代號：2726.HK
- 全球發售：發行 21,492,050 股 H 股，集資 1638.98 百萬港元
- 香港公開發售：發售 2,149,250 股 H 股，占全球發售總量約 10%
- 招股價：76.26 港元
- 每手股數：50 股
- 入場費：3,851.46 港元
- 公開發售日期：2026 年 03 月 20 日至 2026 年 03 月 25 日
- 分配結果日：2026 年 03 月 26 日
- 暗盤日：2026 年 03 月 27 日
- 上市日期：2026 年 03 月 30 日
- 保薦人：中金公司

1.2 企業簡介

公司是全球碳化矽 (SiC) 外延行業的領導者。根據灼識諮詢的報告，自 2023 年來，按年銷售片數計，公司是全球最大的碳化矽外延供應商，2024 年的市場份額超過 30%。在碳化矽外延技術的深厚積累，使公司能始終站在碳化矽外延行業的前沿，並為客戶提供高品質及可靠的產品。公司是全球率先實現 8 英寸碳化矽外延晶片大批量外供的生產商，也是中國首家實現商業化 3 英寸、4 英寸、6 英寸和 8 英寸碳化矽外延晶片批量供應的生產商。公司牽頭撰寫並制定了全球首個及目前唯一的碳化矽外延國際半導體設備與材料產業協會 (SEMI) 行業標準。於 2024 年，公司通過外延片銷售和代工銷售模式累計銷售了超過 164,000 片碳化矽外延晶片；於往績記錄期間，公司累計交付了超過 599,700 片碳化矽外延晶片。於往績記錄期間，公司擁有 134 家客戶。根據灼識諮詢的報告，全球前 5 大碳化矽功率器件巨頭中有 4 家是公司的客戶，全球前 10 大功率器件巨頭中有 8 家是公司的客戶。使用碳化矽外延晶片製備的功率器件在高溫、大功率應用中性能表現穩定。公司的客戶使用公司的碳化矽外延晶片製造產品（通常為功率器件），適用於廣泛的下游工業應用場景，如電動汽車、充電基建、可再生能源、儲能系統，以及新興應用場景，如家電、AI 計算能力和數據中心、智慧電網和 eVTOL。

1.3 基石投資者

瀚天天成引入廈門先進製造業基金為基石投資者，投資金額 7.75 億元，佔發售股份總數的概約百分比為 46.8%。

1.4 保薦人情況

中金公司

代碼	名稱	首日收盤漲跌幅 (%)
7489. HK	嵐圖汽車	
3268. HK	美格智能	1.52
0600. HK	愛芯元智	0.00
2720. HK	樂欣戶外	102.29

6809. HK	瀾起科技	63.72
3200. HK	大族數控	14.82
3986. HK	兆易創新	37.53
0501. HK	豪威集團	16.22
0100. HK	MINIMAX-W	109.09
6938. HK	瑞博生物-B	41.63
2513. HK	智譜	13.17
6082. HK	壁仞科技	75.82
6651. HK	五一視界	29.90
3696. HK	英矽智能	24.66
2635. HK	諾比侃	363.75
2661. HK	輕鬆健康	158.82
2581. HK	明基醫院	-49.46
3881. HK	希迪智駕	-13.69
2676. HK	納芯微	-4.31
9609. HK	海偉股份	-22.97
2685. HK	量化派	88.78
2788. HK	創新實業	32.76
2698. HK	樂舒適	25.95
0699. HK	均勝電子	-8.00
0800. HK	文遠知行-W	-9.96
9927. HK	賽力斯	0.00
2718. HK	明略科技-W	106.10
6687. HK	聚水潭	23.86
2575. HK	軒竹生物-B	126.72
2889. HK	博泰車聯	53.58
9973. HK	奇瑞汽車	3.80
2525. HK	禾賽-W	9.96
2580. HK	奧克斯電氣	-5.40
3858. HK	佳鑫國際資源	177.84
6960. HK	雙登股份	31.29
2631. HK	天岳先進	6.40
2591. HK	銀諾醫藥-B	206.48
6887. HK	東陽光藥	
1304. HK	峰昭科技	16.02
2590. HK	極智嘉-W	5.36
2648. HK	安井食品	-5.00
9678. HK	雲知聲	44.59
6168. HK	週六福	25.00
2050. HK	三花智控	-0.13
3288. HK	海天味業	0.55
2605. HK	METALIGHT	-30.26

2621. HK	手回集團	-18.19
2603. HK	吉宏股份	39.06
2565. HK	派格生物醫藥-B	-25.90
2629. HK	MIRXES-B	28.76
3750. HK	寧德時代	16.43
1333. HK	博雷頓	38.33
3677. HK	正力新能	1.45
6681. HK	腦動極光-B	3.42

二、公司行業發展趨勢以及競爭優勢

2.1 行業基本情況

- 技術特性與應用領域：碳化矽功率半導體器件因其高擊穿電壓、高熱導率、高電子飽和速率及抗輻射能力，廣泛應用於 800V 電動汽車、工業電源、充電基礎設施、工業電機驅動器、電動船舶、智慧電網等領域。與傳統矽基功率半導體相比，碳化矽在中高壓場景中具有更顯著的性能優勢，且市場規模更為龐大。
- 產業鏈結構：上游為碳化矽襯底及外延片的製備，中游為設計、製造、封測，下游為電動汽車、可再生能源、儲能系統等終端應用。外延片製造技術壁壘高，占整個碳化矽功率器件價值鏈的 25%，是產業鏈中的關鍵環節。
- 市場集中度與成本結構：公司原材料成本占銷售成本的 50% 以上，且採購集中度高，往績記錄期間向五大供應商採購金額占比超過 70%。原材料價格波動及供應穩定性對公司的盈利能力構成直接影響。

2.2 未來發展趨勢

- 晶圓尺寸升級與產能擴張：為實現成本優勢並增強市場競爭力，行業普遍需將 6 英寸晶圓生產線升級至 8 英寸。此過程需要大量前期資本投入，且技術難度較高。
- 技術進步與良率提升：外延生長技術的持續改進（如降低缺陷密度、提高均勻性）是推動行業發展的關鍵因素。公司已通過良率改善部分抵消了原材料採購價格上漲的影響。
- 下游需求持續增長：碳化矽功率半導體器件在電動汽車、智慧電網、儲能系統等領域的滲透率持續提升。根據灼識諮詢報告，這些下游行業的發展將直接帶動碳化矽功率半導體的市場需求。

三、財務與經營情況

綜合損益及其他全面收益表概要方面，截至 2025 年 9 月 30 日止九個月公司收入為 5.35 億元，毛利率為 26.6%，期內利潤為 0.21 億元。按業務分部劃分的收入方面，外延片銷售收入為 4.83 億元，占比為 90.3%，毛利率為 29.6%；外延片代工收入為 0.23 億元，占比 4.3%，毛利率為 10.7%；其他收入為 0.28 億元，占比為 5.3%，毛利率為-30.2%。

四、公司發展戰略與競爭優勢

4.1 碳化矽外延晶片業務占比高

公司主要業務圍繞碳化矽外延晶片的生產與銷售展開。公司與客戶關係穩定，且無主要股東或董事在前五大客戶中持有權益。業務銷量方面，公司依賴少數關鍵供應商。競爭優勢方面，公司具備較強的研發能力。公司產品廣泛應用於電動汽車、充電基建、可再生能源、儲能系統等領域，並在 AI 計算能力、資料中心等新興市場中拓展。

4.2 公司競爭優勢

- 技術積累與研發能力：公司具備完整的碳化矽外延片製造工藝，涵蓋長晶、外延、光刻、刻蝕、沉積、減薄、封測等環節，且持續投入研發以提升技術壁壘。
- 成本控制與供應鏈管理：公司通過優化採購結構和提升襯底良率，有效緩解了原材料成本上升的壓力。未來若原材料價格進一步下降，將有助於提升毛利率。
- 市場定位與客戶基礎：公司產品主要面向各行業的下游客戶，客戶應用場景廣泛，包括電動汽車、充電基建、可再生能源、儲能系統等，具備較強的市場適應能力。

4.3 8 英寸晶圓推動盈利增長

公司未來戰略聚焦 8 英寸碳化矽外延晶片的規模化生產，以降低單位成本並提升市場佔有率。8 英寸晶片的主流價格維持在每片 1,000 美元以上，且隨著技術成熟及襯底成本下降，其銷售占比將逐步提升，成為支撐盈利能力的關鍵產品。公司計畫通過自動化生產線建設，提高生產效率和良率，進一步降低製造成本，實現產品性能與成本的最優平衡。

4.4 技術升級與產品優化

公司持續投入研發資源，重點優化 6 英寸及 8 英寸碳化矽外延晶片的製造工藝，提升其均勻性、厚度及缺陷控制能力。通過開發更高性能的碳化矽超結器件外延技術，以及低缺陷密度的 8 英寸晶片，公司致力於為客戶提供更可靠、更高效的解決方案。研發方向與客戶早期需求緊密結合，增強客戶黏性並拓展長期合作空間。

4.5 市場拓展與客戶深化

公司實施境內與境外雙輪驅動策略，深化與全球功率器件領先企業的合作，同時拓展新興市場，如家電、AI 計算、資料中心、智慧電網及 eVTOL 等。通過定制化服務、參與行業展會及推動標準制定，公司提升品牌影響力，並將市場認知轉化為實際訂單。此外，公司強化與重點客戶的聯合研發，以增強客戶忠誠度和市場滲透率。